



## 平成28年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

平成29年2月8日  
上場取引所 東

上場会社名 株式会社 SUMCO

コード番号 3436 URL <http://www.sumcosi.com/>

代表者 (役職名) 代表取締役 会長兼CEO

(氏名) 橋本 眞幸

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 広報・IR室長

(氏名) 澁谷 博史

TEL 03-5444-3915

定時株主総会開催予定日 平成29年3月29日

配当支払開始予定日

平成29年3月9日

有価証券報告書提出予定日 平成29年3月29日

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・証券アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成28年12月期の連結業績(平成28年1月1日～平成28年12月31日)

#### (1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年12月期	211,361	△10.8	14,046	△52.3	9,919	△61.2	6,588	△66.6
27年12月期	236,826	5.1	29,447	14.8	25,538	16.5	19,747	21.2

(注) 包括利益 28年12月期 4,122百万円 (△81.1%) 27年12月期 21,763百万円 (△19.2%)

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり 当期純利益	自己資本当期純利益 率	総資産経常利益率	売上高営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
28年12月期	22.46	—	3.1	2.0	6.6
27年12月期	70.06	67.77	10.0	5.1	12.4

(参考) 持分法投資損益 28年12月期 一百万円 27年12月期 一百万円

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
28年12月期	493,243	242,836	42.5	715.46
27年12月期	489,842	244,540	43.2	721.78

(参考) 自己資本 28年12月期 209,829百万円 27年12月期 211,682百万円

#### (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
28年12月期	27,322	△18,003	△9,120	45,565
27年12月期	31,768	△13,416	△38,136	45,809

### 2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産配当 率(連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
27年12月期	—	10.00	—	10.00	20.00	5,865	28.5	3.2
28年12月期	—	5.00	—	5.00	10.00	2,932	44.5	1.4
29年12月期(予想)	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 現時点において平成29年12月期の1株当たり配当金については未定であります。

### 3. 平成29年12月期 第1四半期の連結業績予想(平成29年1月1日～平成29年3月31日)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり当期 純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第1四半期	59,000	13.9	7,000	93.7	4,500	68.2	3,000	90.3	10.23

(注) 当社は、翌四半期累計期間の連結業績予想を開示する方針としております。詳細は、添付資料2ページの「1. 経営成績・財政状態に関する分析(1) 経営成績に関する分析」をご覧ください。

※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(注)詳細は、添付資料 7ページの「2. 企業集団の状況」をご覧ください。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有  
 ② ①以外の会計方針の変更 : 無  
 ③ 会計上の見積りの変更 : 無  
 ④ 修正再表示 : 無

(注)詳細は、添付資料 16ページの「5. 連結財務諸表 (5)連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」をご覧ください。

(3) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)  
 ② 期末自己株式数  
 ③ 期中平均株式数

28年12月期	293,285,539 株	27年12月期	293,285,539 株
28年12月期	7,046 株	27年12月期	6,766 株
28年12月期	293,278,695 株	27年12月期	281,860,998 株

(参考)個別業績の概要

平成28年12月期の個別業績(平成28年1月1日～平成28年12月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年12月期	167,138	△10.8	4,893	△67.7	2,345	△80.4	3,667	△68.0
27年12月期	187,395	5.6	15,141	30.7	11,984	32.7	11,448	17.9

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
28年12月期	12.51	—
27年12月期	40.62	—

(2) 個別財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%	円 銭		
28年12月期	436,850		186,010		42.6	634.24		
27年12月期	432,569		189,155		43.7	644.97		

(参考) 自己資本 28年12月期 186,010百万円 27年12月期 189,155百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、連結財務諸表に対する監査手続が実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料 2ページの「1. 経営成績・財政状態に関する分析(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。

(配当についての特記事項)

平成29年12月期の1株当たり配当金については未定としております。当該予想の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。詳細は、添付資料 4ページの「1. 経営成績・財政状態に関する分析(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」をご覧ください。

(決算説明資料の入手方法)

当社は平成29年2月8日に機関投資家・証券アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で使用する決算説明資料については、同日、当社ウェブサイトに掲載する予定です。

## 【添付資料】

### 添付資料の目次

1. 経営成績・財政状態に関する分析	
(1) 経営成績に関する分析	P. 2
(2) 財政状態に関する分析	P. 3
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当	P. 4
(4) 事業等のリスク	P. 4
2. 企業集団の状況	P. 7
3. 経営方針	
(1) 会社の経営の基本方針	P. 8
(2) 目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略	P. 8
(3) 会社の対処すべき課題	P. 8
4. 会計基準の選択に関する基本的な考え方	P. 8
5. 連結財務諸表	
(1) 連結貸借対照表	P. 9
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	P. 11
(3) 連結株主資本等変動計算書	P. 13
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	P. 15
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	P. 16

## 1. 経営成績・財政状態に関する分析

### (1) 経営成績に関する分析

#### ①当期の経営成績

当連結会計年度における半導体用シリコンウェーハ市場は、年初は在庫調整の影響が残りましたが、春先以降にスマートフォンの高機能化や通信量の増加によるデータセンター向けウェーハ需要が伸長し、強い需要が継続しました。

300mm ウェーハは、メモリー向け需要の成長に加え、春先以降はロジック向けの需要も拡大し、需給がひっ迫する状況が続きました。また、200mm 以下の小口径ウェーハも、長らく需要減少が続いておりましたが、自動車・産業・通信・IoT等の需要により回復基調に転じました。

一方、円高の進行は、当社グループの業績にも影響を与えました。

このような環境のもと、当社グループでは、「SUMCO ビジョン」の方針に基づき、顧客の高精度化要求や製品の差別化に対応した技術開発により顧客でのプレゼンスを高めるとともに、コスト低減による損益分岐点の改善に努めてまいりました。

以上の結果、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高 211,361 百万円、営業利益 14,046 百万円、経常利益 9,919 百万円、親会社株主に帰属する当期純利益 6,588 百万円となりました。

#### ②次期の見通し

平成 29 年度第 1 四半期の半導体用シリコンウェーハ市場は、300mm・200mm とともに需要のひっ迫が継続すると予想しております。

このような市場環境のなか、当社グループでは、引き続き最先端技術開発の推進による製品の差別化を図るとともに、更なるコスト合理化及び生産性向上の継続により、収益基盤を強化してまいります。

なお、当社グループが属する半導体業界は事業環境が短期間に大きく変化するという特徴があり、第 2 四半期（累計）及び通期の合理的な予想を行うことが困難であることから、翌四半期累計期間の連結業績予想を開示する方針としております。

以上にに基づき、平成 29 年 12 月期第 1 四半期の連結業績予想について、下記の通り開示いたします。

平成 29 年 12 月期第 1 四半期 業績予想（平成 29 年 1 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 四半期純利益	1 株当たり 四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
今回予想	59,000	7,000	4,500	3,000	10.23
(ご参考) 前年同期実績 (H28 年 12 月期第 1 四半期)	51,779	3,612	2,675	1,576	5.37

(注 1) 業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

(注 2) 平成 29 年 12 月期 第 1 四半期の業績予想にあたっては、1 米ドル=114 円を前提としております。

## (2) 財政状態に関する分析

## ①資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ3,400百万円増加し、493,243百万円となりました。償却の進行・長期前渡金の取り崩し等により固定資産が12,799百万円減少した一方で、原材料及び貯蔵品が17,185百万円増加したことがその主な要因であります。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ5,105百万円増加し、250,407百万円となりました。短期借入金の減少等により流動負債が6,358百万円減少した一方で、長期借入金の増加等により固定負債が11,464百万円増加したことがその要因であります。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,704百万円減少し、242,836百万円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益等により利益剰余金が2,188百万円増加した一方で、繰延ヘッジ損益が2,483百万円減少したこと、及び為替換算調整勘定が1,516百万円減少したことがその主な要因であります。

## ②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ243百万円減少し、45,565百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが27,322百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△18,003百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△9,120百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額が△442百万円となったことによるものであります。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

## (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ4,446百万円減少し、27,322百万円となりました。これは、仕入債務が増加した一方で、税金等調整前当期純利益が減少したこと、及び売上債権が増加したことが主な要因であります。

## (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ支出が4,586百万円増加し、△18,003百万円となりました。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出が増加したことが主な要因であります。

## (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、△9,120百万円となりました。これは長期借入れによる収入が63,234百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出が△49,177百万円、短期借入金の純増減額が△17,796百万円、配当金の支払額が△4,399百万円あったことが主な要因であります。

## (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成25年 1月期	平成25年 12月期	平成26年 12月期	平成27年 12月期	平成28年 12月期
自己資本比率 (%)	32.2	33.7	36.2	43.2	42.5
時価ベースの 自己資本比率 (%)	49.6	48.0	88.3	55.3	89.8
キャッシュ・フロー 対有利子負債比率 (年)	14.7	102.0	7.4	5.7	6.5
インタレスト・ カバレッジ・レシオ (倍)	4.9	0.7	8.2	9.4	9.5

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注1) いずれも連結ベースの財務諸表により計算しております。

(注2) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

(注3) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。

(注4) 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。

(注5) 平成25年12月期は決算期変更に伴い、11ヶ月の変則決算となっております。

### (3) 利益分配に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、定款に基づき、取締役会決議により剰余金の配当等を行うこととしております。また、当社の剰余金の配当に関する基本方針は、各事業年度における利益水準、次期以降の見通し、設備投資に係る資金需要及び内部留保の状況等を総合的に勘案した上で、決定していくこととしております。

なお、当期の普通株式期末配当金につきましては、中間配当金と同額の1株当たり5円(年間10円)を予定しております。また、平成29年12月期の普通株式配当予想につきましては、現時点においては未定とさせていただきます。

### (4) 事業等のリスク

当社グループは、以下のような事項を当社グループの経営並びに事業遂行上の主要なリスク要因と認識しており、その発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。これらの要因により、当社グループの事業、経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。

なお、以下の事項のうち将来に関する事項は、提出日現在において当社グループが判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

#### ① 事業環境について

当社グループが製造及び販売するシリコンウェーハは、パソコン、スマートフォン、タブレット型端末といった携帯端末、自動車、及びその他民生品を含む各種製品に使用される半導体基板等に用いられることから、半導体やその周辺産業に特徴的な諸要因の影響を受けることがあります。かかる諸要因には、急激な市況悪化、急速な技術革新の進展、製品の陳腐化、製品構成の急速な変化、製品価格の下落、特定顧客との取引の集中とその特定顧客からの受注の大幅な変動、同業他社との競争優位性の変化に伴う当社グループの競争力の変動、及び顧客需要の大きな振幅等があり、これらは当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

また、主な取引先のある国を含む各国の政治情勢やエネルギーを始めとする資源価格及び電力価格の変動等といった国内外の経済情勢が、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

#### ② 当社グループの製品について

当社グループの製品が用いられる半導体の価格は、製品の市場投入後は普及による販売数量拡大等の影響もあり、一般的に低下する傾向にあります。当社グループにおいては、量産化による販売数量の拡大や製造工程等における歩留率向上等の合理化を進めることにより、当該製品価格低下を想定した事業計画を策定しておりますが、急激な需給バランスの悪化、その他の事由により想定以上の販売価格低下が生じる場合、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

なお、上記以外にも、品質の不適合(具体的には、当社グループが顧客に納入した製品について、顧客の要求規格及び仕様等を充足しない場合、または不適合等が生じる場合に重大な品質クレームを引き起こす可能性)、生産性向上の未達成等(具体的には、製品製造工程における歩留率改善等による継続した生産効率の向上が図られない場合の利益の圧迫要因、もしくは製造設備の事故やシステム障害、その他の要因による製造の中断、あるいは大幅な遅延等が生じる場合に、当社グループ全体の生産能力低下や特定製品の供給が困難となる可能性等)が当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

#### ③ 原材料の調達について

シリコンウェーハの主要原材料は、極めて純度の高い多結晶シリコンであり、製造者が限定されていることから、供給不安のリスクがあります。そのため、当社グループは、世界の主要な多結晶シリコンメーカー

との間で、多結晶シリコンメーカーが一定期間に一定の数量を供給し、当社グループが購入する旨の長期購入契約を締結し、原材料の安定調達を図ってまいりましたが、長期購入契約締結時の需要予想と足元の消費見通しに乖離が生じていることから在庫が増加しております。

また、長期購入契約においては、契約期間中の購入価格水準が決められていることから、これらが終了し在庫水準が適正な水準に回復するまでの間は、原材料コスト低減の機会が制約される可能性があります。

原材料在庫を含む「原材料及び貯蔵品」の見通しについては、「3. 経営方針(3) 会社の対処すべき課題」に記載した通りであります。事業環境の著しい変化等により、消費量が変動した場合、あるいは、会計上の対応が必要となる場合、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

#### ④ 主要製造設備の安定調達について

当社の主要製造設備には、当社と設備機器メーカーとの間で共同開発した両面研磨機等、他メーカーへの切り替えができない設備があります。これらの円滑な調達が困難な場合には、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

#### ⑤ 顧客及びサプライヤーに係るリスク（経営破綻・操業停止等）について

当社グループは、顧客の与信管理には万全を期しておりますが、仮に顧客が倒産し、多額の売上債権が回収不能となる場合、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。また、当社は諸資材の調達については、複数のメーカーと契約及び在庫の積み上げ等、調達途絶リスクを回避する施策を講じておりますが、経済環境の急激な変動、自然災害及び設備事故等によるサプライヤーの操業停止あるいは倒産等により、諸資材等の調達に支障を来す場合、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

#### ⑥ 設備投資について

当社グループは中長期的な需要予測に基づいて設備投資を実施しておりますが、経済動向や半導体業界を取り巻く環境の変化により、需要予測に大幅な変化が生じる場合には、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

#### ⑦ 資金調達について

当社グループのシンジケート・ローン契約等につきましては、財政状況の著しい悪化により、その財務制限条項に抵触し、当該借入金について返還請求を受け期限の利益を失った場合には、当社グループの資金調達に影響を及ぼす可能性があります。

また、金利水準や市場環境等の要因により当社グループが希望する時期または条件により資金調達が実行できない場合には、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

#### ⑧ 技術及び研究開発について

半導体業界は、急速な技術革新が進む業界であり、半導体の高集積化、細密化や半導体用途の多様化、高精度化及び生産効率の向上等、当社グループのシリコンウェーハに対して顧客より要求される各種技術は多岐に亘り、かつ、高度化しております。当社グループは、かかる顧客からの要求に応えるため、中長期的に需要の拡大が見込まれる300mmウェーハに関する技術、品種別ではエピタキシャルウェーハ等の高付加価値ウェーハ関連技術、さらに、次世代ウェーハ製品の関連技術等に重点をおいた研究開発活動を行っております。

しかしながら、業界における技術進歩への対応に支障が生じ、顧客の要求に適合することが困難となり、研究開発活動が想定した効果を得られない場合や、他社に比べ技術開発が遅れた場合には、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

#### ⑨ 知的財産権について

当社グループは、シリコンウェーハ業界において競合他社に対抗していくためには、特許権その他の知的財産権の確保が非常に重要であると認識しており、国内外において出願中のものを含めて多数の特許を保有しております。

また、当社グループが保有する特許技術は、欠陥を高度に制御した結晶、高精度の研磨、高品質のエピタキシャルウェーハ等多岐に亘りますが、高度化する技術要求に対応して行われる日々の開発活動からの成果

についても、積極的に特許化を進めております。

しかしながら、当社グループが認識しない第三者の特許が既に成立している場合において、当該第三者より知的財産権を侵害しているとの事由により、使用差止及び損害賠償等の訴えを起こされる場合、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑩ 海外展開について

当社グループは、全世界の主要な半導体メーカー等に対してシリコンウェーハを供給しておりますが、生産・販売活動については、日本国内に加えて、北米、欧州及びアジアにそれぞれ拠点を設置し事業を展開しております。当社グループのこれらの生産及び販売活動には、各国及び各地域等の経済情勢、政治情勢、法規制、税制、為替規制等の変化による影響や、現地での紛争、テロや災害の発生、感染症の流行、社会・労働慣行の相違、社会的インフラの未整備等による影響を受ける可能性があります。

⑪ 為替相場の変動について

当社グループは、製品の輸出等において外貨建て取引を行っており、また、連結財務諸表を作成するにあたって海外連結子会社の財務諸表を円換算していることから、為替相場の変動は当社グループの経営成績、財務状態等に影響を及ぼす可能性があります。

⑫ 環境規制等について

当社グループの事業は、主に製造拠点において、エネルギーの使用、排気、排水、有害化学物質の使用及び保管、産業廃棄物の廃棄、土壌及び地下水の汚染の検査及び浄化等、環境に関する多くの国内外の法的規制を受けており、これらの規制に基づき一定の費用負担や賠償義務その他法的責任が生じる可能性があります。また、近年においては、一般的にこれら環境等に関する規制は強化される傾向にあります。今後において環境等に関する新たな国内外の法規制等が制定される可能性は否定できず、そのような場合、当社グループにおいて、これら法規制等への対応のために新たな費用負担等が生じることが予想され、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑬ 自然災害、事故等のリスクについて

当社グループの各製造拠点において、台風、豪雨、地震、津波または火山活動等の自然災害や、事故、火災、テロ等により、生産の停止、設備の損壊や給水・電力供給の制限等の不測の事態が発生する場合には、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

特に、当社グループの主力商品である300mmウェーハの加工工程を有する製造拠点が、上記の自然災害、事故、火災等に見舞われる場合、300mmウェーハの製造・販売に支障を来し、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑭ 企業買収に関するリスクについて

当社は、企業買収の実施に当たり、当該企業の財務内容等についてデューデリジェンスを行い、事前にリスク回避するように努めておりますが、事業環境の急激な変化等、不測の事態が生じる場合、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑮ 上記以外のリスクについて

当社グループは、事業環境の変化等により、以下のような事態が生じる場合、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼすことがあります。

- a. 事業環境の大幅な変化により事業及び組織の再構築等が必要となる事態が生じる場合。
- b. 退職給付債務に関して、今後当社の年金資産の時価の下落、運用利回りの低下、または退職給付債務を計算する数理計算上の前提条件の大幅な変化が生じる場合。
- c. 経済環境の変化等により、収益が悪化し、または将来の収益の見積りが大幅に変動する等により、会計上の対応が必要となる場合。
- d. 当社グループの事業に必要な人材を確保できない場合。
- e. 当社グループの製品の不具合等に起因する争訟やその他の争訟が生じた場合。
- f. 内部統制が有効に機能しない事態が生じる場合。

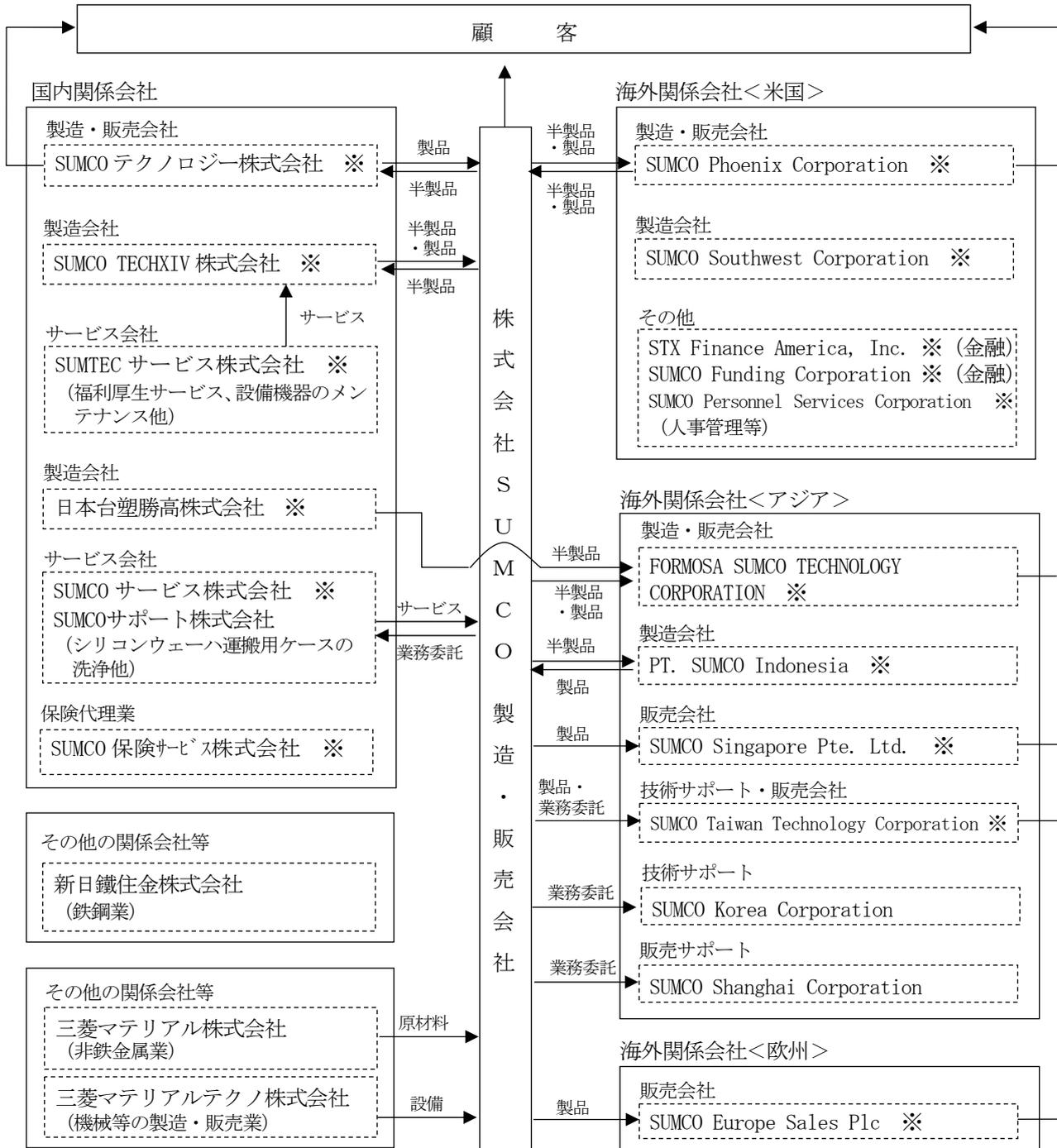
## 2. 企業集団の状況

当社の関係会社は国内子会社 8 社（連結子会社 6 社、非連結子会社 2 社）及び海外子会社 12 社（連結子会社 10 社、非連結子会社 2 社）であります。また、当社のその他の関係会社は新日鐵住金株式会社と三菱マテリアル株式会社であり、当社は当該両社のグループに属しております。

当社と当社の子会社で構成されるグループ（以下「当社グループ」といいます。）の事業は「高純度シリコン事業」のみであります。

### [事業系統図]

以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。（※は連結子会社）



(注) 日鉄住金ファインテック株式会社(現 日鉄住金精密加工株式会社)は平成 28 年 3 月末をもって、半導体装置を含む産業機械装置から撤退いたしました

### 3. 経営方針

#### (1) 会社の経営の基本方針

当社グループは「お客様と株主の期待に応え、従業員に幸せを与え、社会に貢献する、常に世界一のシリコンウェーハメーカーを目指す」という経営理念のもと、半導体デバイスに使用される高品質のシリコンウェーハ製造において、大口径から小口径までカバーする幅広い製品展開力と技術力を有し、これらを最大限に活用し安定的な供給体制を構築することにより、社会の発展に貢献してまいります。特に、顧客からの極めて厳しい品質・コスト要求に応える技術力の向上に傾注し、シリコンウェーハ業界における地位の維持・向上を図ってまいります。

当社グループは、この基本方針のもと、事業基盤を更に強化し、事業の持続的成長を目指し、ステークホルダーの負託に応じてまいり所存であります。

#### (2) 目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略

半導体シリコンウェーハは、短期的な変動要因はあるものの中長期的には半導体市場の成長とともに拡大していく見通しであります。最先端の微細化対応した 300mm ウェーハが成長を牽引します。一方、200mm ウェーハは車載・民生・通信向け等に下支えされ、需要は中長期的に底堅く推移するものと予想しております。

このような環境の中、主力製品である 300mm ウェーハについては、微細化技術の進展とともにますます厳しくなる高精度化の品質要求に対応する技術開発・投資による更なる差別化を図ってまいります。また、生産能力を上回る需要の対応については、経済合理性を十分に検討のうえこれに対処する所存であります。200mm 以下のウェーハについては、市場環境に見合った適正な生産体制の構築を実現してまいります。また、コスト競争力の強化に加え、IOTやパワー半導体向け等今後の需要拡大が期待される分野へ経営資源を集中し差別化を図ります。

なお、半導体シリコンウェーハは、市場環境の変化が大きい事業分野に位置しているため、引き続き損益分岐点の引き下げに加え、需要環境の変化に迅速かつ適正に対応できる企業体質の構築を図ってまいります。

また、当社グループは、中期的に自己資本比率で 50%以上、グロスD/Eレシオで 0.5 倍以下の財務体質を目標としております。

#### (3) 会社の対処すべき課題

足許の半導体ウェーハの需要は旺盛で、特に主力の 300mm ウェーハについては、顧客からの要請に応え切れない状況となっております。加えて、半導体シリコンウェーハ市場は、スマートフォン・車載・通信・産業向け等の需要に支えられ、今後も緩やかな成長が見込まれております。

このような環境のもと、当社グループでは、引き続き「SUMCOビジョン」の方針に基づき、顧客の高精度化要求や製品の差別化に対応した技術開発により顧客でのプレゼンスを高めるとともに、コスト低減による損益分岐点の改善に努めてまいります。また、生産性の向上により、顧客の需要に応えるべく、努力してまいります。

なお、シリコンウェーハの主要原材料である多結晶シリコンにつきましては、市場の急激な変化に伴い、長期購入契約締結時の需要予測と足元の消費見通しに乖離が生じていることにより、現在余剰在庫を保有しており、原材料在庫を含む「原材料及び貯蔵品」の残高は、対前年度末比、172 億円増加の 1,514 億円となっております。

「原材料及び貯蔵品」の残高は、今後、徐々に長期購入契約の期間満了を迎えることから、減少に転じ、中長期的には適正水準に回復する見込みであります。

### 4. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは日本基準に基づき連結財務諸表を作成しており、当面は日本基準で連結財務諸表を作成する方針であります。

## 5. 連結財務諸表

## (1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年12月31日)	当連結会計年度 (平成28年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	41,913	39,065
受取手形及び売掛金	41,002	44,927
有価証券	5,000	6,500
商品及び製品	16,158	13,272
仕掛品	13,229	13,689
原材料及び貯蔵品	134,224	151,410
繰延税金資産	266	41
その他	7,035	6,123
貸倒引当金	△11	△10
流動資産合計	258,818	275,019
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	195,448	195,671
減価償却累計額	△112,647	△117,702
建物及び構築物(純額)	82,800	77,968
機械装置及び運搬具	726,191	731,757
減価償却累計額	△676,828	△683,558
機械装置及び運搬具(純額)	49,362	48,198
土地	20,286	20,272
建設仮勘定	5,077	3,255
その他	14,567	14,560
減価償却累計額	△13,510	△13,485
その他(純額)	1,057	1,075
有形固定資産合計	158,585	150,771
無形固定資産		
のれん	10,063	8,438
ソフトウェア	2,709	4,241
その他	1,186	627
無形固定資産合計	13,959	13,306
投資その他の資産		
投資有価証券	81	82
長期前渡金	47,370	44,032
長期前払費用	3,676	3,354
繰延税金資産	6,494	5,842
その他	1,241	1,213
貸倒引当金	△385	△378
投資その他の資産合計	58,479	54,145
固定資産合計	231,024	218,224
資産合計	489,842	493,243

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年12月31日)	当連結会計年度 (平成28年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	22,884	27,764
短期借入金	70,235	55,847
リース債務	1,254	1,665
未払法人税等	1,451	1,053
賞与引当金	1,231	1,154
設備関係支払手形及び設備関係未払金	5,708	3,296
その他	8,785	14,410
流動負債合計	111,550	105,191
固定負債		
長期借入金	105,988	116,637
リース債務	2,887	2,935
繰延税金負債	1,800	1,247
再評価に係る繰延税金負債	1,413	1,342
退職給付に係る負債	20,058	21,523
その他	1,604	1,528
固定負債合計	133,751	145,215
負債合計	245,301	250,407
純資産の部		
株主資本		
資本金	138,718	138,718
資本剰余金	23,384	23,384
利益剰余金	48,502	50,691
自己株式	△11	△11
株主資本合計	210,594	212,783
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	0	0
繰延ヘッジ損益	△0	△2,484
土地再評価差額金	2,816	2,886
為替換算調整勘定	1,753	236
退職給付に係る調整累計額	△3,481	△3,593
その他の包括利益累計額合計	1,088	△2,954
非支配株主持分	32,857	33,007
純資産合計	244,540	242,836
負債純資産合計	489,842	493,243

## (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

(連結損益計算書)

## 【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
売上高	236,826	211,361
売上原価	182,272	173,092
売上総利益	54,553	38,268
販売費及び一般管理費	25,106	24,222
営業利益	29,447	14,046
営業外収益		
受取利息	88	76
受取配当金	26	18
受取保険金	2	291
助成金収入	389	89
その他	445	166
営業外収益合計	952	642
営業外費用		
支払利息	3,297	2,775
為替差損	12	1,463
その他	1,552	530
営業外費用合計	4,861	4,769
経常利益	25,538	9,919
特別利益		
固定資産売却益	323	—
特別利益合計	323	—
特別損失		
減損損失	2,043	—
特別損失合計	2,043	—
税金等調整前当期純利益	23,818	9,919
法人税、住民税及び事業税	1,745	1,053
法人税等調整額	△1,328	90
法人税等合計	416	1,144
当期純利益	23,401	8,775
非支配株主に帰属する当期純利益	3,653	2,187
親会社株主に帰属する当期純利益	19,747	6,588

(連結包括利益計算書)

## 【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
当期純利益	23,401	8,775
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	0	0
繰延ヘッジ損益	0	△2,483
土地再評価差額金	145	70
為替換算調整勘定	△1,743	△2,143
退職給付に係る調整額	△40	△97
その他の包括利益合計	△1,638	△4,653
包括利益	21,763	4,122
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	19,054	2,545
非支配株主に係る包括利益	2,709	1,576

## (3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自平成27年1月1日 至平成27年12月31日)

(単位:百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	136,607	15,676	30,946	△10	183,220
会計方針の変更による累積的影響額			2,896		2,896
会計方針の変更を反映した当期首残高	136,607	15,676	33,843	△10	186,116
当期変動額					
新株の発行	32,111	32,111			64,223
資本金から剰余金への振替	△30,000	30,000			—
剰余金の配当			△5,088		△5,088
親会社株主に帰属する当期純利益			19,747		19,747
自己株式の取得				△54,404	△54,404
自己株式の消却		△54,403		54,403	—
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	2,111	7,708	14,658	△0	24,478
当期末残高	138,718	23,384	48,502	△11	210,594

	その他の包括利益累計額						非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	0	△1	2,670	2,600	△3,488	1,781	31,723	216,725
会計方針の変更による累積的影響額								2,896
会計方針の変更を反映した当期首残高	0	△1	2,670	2,600	△3,488	1,781	31,723	219,622
当期変動額								
新株の発行								64,223
資本金から剰余金への振替								—
剰余金の配当								△5,088
親会社株主に帰属する当期純利益								19,747
自己株式の取得								△54,404
自己株式の消却								—
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	145	△847	7	△693	1,134	440
当期変動額合計	0	0	145	△847	7	△693	1,134	24,918
当期末残高	0	△0	2,816	1,753	△3,481	1,088	32,857	244,540

当連結会計年度（自平成28年1月1日 至平成28年12月31日）

（単位：百万円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	138,718	23,384	48,502	△11	210,594
会計方針の変更による累積的影響額					
会計方針の変更を反映した当期首残高	138,718	23,384	48,502	△11	210,594
当期変動額					
新株の発行					
資本金から剰余金への振替					
剰余金の配当			△4,399		△4,399
親会社株主に帰属する当期純利益			6,588		6,588
自己株式の取得				△0	△0
自己株式の消却					
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	2,188	△0	2,188
当期末残高	138,718	23,384	50,691	△11	212,783

	その他の包括利益累計額						非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	0	△0	2,816	1,753	△3,481	1,088	32,857	244,540
会計方針の変更による累積的影響額								
会計方針の変更を反映した当期首残高	0	△0	2,816	1,753	△3,481	1,088	32,857	244,540
当期変動額								
新株の発行								
資本金から剰余金への振替								
剰余金の配当								△4,399
親会社株主に帰属する当期純利益								6,588
自己株式の取得								△0
自己株式の消却								
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	0	△2,483	70	△1,516	△112	△4,042	149	△3,893
当期変動額合計	0	△2,483	70	△1,516	△112	△4,042	149	△1,704
当期末残高	0	△2,484	2,886	236	△3,593	△2,954	33,007	242,836

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	23,818	9,919
減価償却費	21,795	22,002
減損損失	2,043	—
のれん償却額	1,657	1,625
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2	△0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	313	△47
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	1,237	1,382
受取利息及び受取配当金	△115	△95
支払利息	3,297	2,775
固定資産除売却損益 (△は益)	△183	260
売上債権の増減額 (△は増加)	1,367	△4,139
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△13,062	△15,327
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△452	947
仕入債務の増減額 (△は減少)	△6,655	5,326
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△2,628	3,291
その他	3,933	3,839
小計	36,366	31,761
利息及び配当金の受取額	115	95
利息の支払額	△3,394	△2,883
法人税等の支払額	△1,318	△1,650
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,768	27,322
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△12,656	△18,688
その他	△760	684
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,416	△18,003
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	15,287	△17,796
長期借入れによる収入	4,000	63,234
長期借入金の返済による支出	△60,416	△49,177
セール・アンド・リースバックによる収入	1,500	1,998
リース債務の返済による支出	△1,192	△1,554
株式の発行による収入	63,753	—
自己株式の取得による支出	△54,404	△0
配当金の支払額	△5,088	△4,399
非支配株主への配当金の支払額	△1,575	△1,427
財務活動によるキャッシュ・フロー	△38,136	△9,120
現金及び現金同等物に係る換算差額	△123	△442
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△19,907	△243
現金及び現金同等物の期首残高	65,716	45,809
現金及び現金同等物の期末残高	45,809	45,565

## (5) 連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業的前提に関する注記)

該当事項はありません。

## (会計方針の変更)

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、  
「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)  
及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)  
等を当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前連結会計年度については、連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。

なお、この変更による連結財務諸表に与える影響はありません。

## (平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当連結会計年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響は軽微であります。

## (セグメント情報等)

## a. セグメント情報

前連結会計年度(自平成27年1月1日 至平成27年12月31日)及び当連結会計年度(自平成28年1月1日 至平成28年12月31日)

当社グループは「高純度シリコン事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## b. 関連情報

前連結会計年度(自平成27年1月1日 至平成27年12月31日)

## 1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 売上高

(単位:百万円)

日本	北米	アジア	欧州他	合計
54,889	34,666	127,575	19,694	236,826

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

## (2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日本	アジア	その他	合計
111,765	42,055	4,764	158,585

## 3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
住友商事株式会社	34,931	高純度シリコン

当連結会計年度（自平成28年1月1日 至平成28年12月31日）

## 1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 売上高

(単位：百万円)

日本	北米	アジア	欧州他	合計
53,653	28,057	112,737	16,913	211,361

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

## (2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日本	アジア	その他	合計
107,439	38,941	4,390	150,771

## 3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
住友商事株式会社	30,767	高純度シリコン
Samsung Electronics Co., Ltd	22,638	高純度シリコン

## c. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

前連結会計年度（自平成27年1月1日 至平成27年12月31日）

当社グループの事業は「高純度シリコン」のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成28年1月1日 至平成28年12月31日）

該当事項はありません。

## d. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

前連結会計年度（自平成27年1月1日 至平成27年12月31日）及び当連結会計年度（自平成28年1月1日 至平成28年12月31日）

当社グループの事業は「高純度シリコン」のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## e. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

前連結会計年度（自平成27年1月1日 至平成27年12月31日）及び当連結会計年度（自平成28年1月1日 至平成28年12月31日）

該当事項はありません。

## (1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
1株当たり純資産額	721円78銭	715円46銭
1株当たり当期純利益金額	70円06銭	22円46銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	67円77銭	—

(注) 1. 当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
1株当たり当期純利益金額		
親会社株主に帰属する当期純利益金額 (百万円)	19,747	6,588
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株主に係る親会社株主に帰属する 当期純利益金額(百万円)	19,747	6,588
普通株式の期中平均株式数(株)	281,860,998	293,278,695
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額		
親会社株主に帰属する当期純利益調整額 (百万円)	—	—
普通株式増加数(株)	9,534,441	—
(うち優先株式(株))	(9,534,441)	(—)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1株当たり当期純利益の算定に含めなかった 潜在株式の概要	—————	

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

以 上